

超配（维持）

半导体行业双周报（2024/11/18-2024/11/29）

Q3 全球个人智能音频设备出货量实现同比增长

2024年11月29日

刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

陈伟光

SAC 执业证书编号：

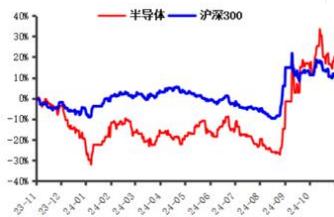
S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

投资要点：

- **半导体行业指数近两周涨跌幅：**截至2024年11月29日，申万半导体行业指数近两周（2024/11/18-2024/11/29）累计上涨0.29%，跑赢沪深300指数1.61个百分点；11月以来累计上涨2.34%，跑赢沪深300指数1.68个百分点；2024年以来累计上涨24.79%，跑赢沪深300指数10.64个百分点。
- **近两周部分新闻和公司动态：**（1）Canalys：2024年Q3全球个人智能音频设备出货量同比增长15%；（2）机构：需求展望疲弱，预计2025年DRAM价格将下跌；（3）机构：2024年前三季度全球存储市场规模突破1200亿美元；（4）小米集团：第三季度营收925.1亿元，同比增长30.5%；（5）小米集团：第三季度智能手机收入同比增加13.9%至475亿元；（6）渠道存储市场氛围转淡，本周渠道SSD和内存条多数小跌；（7）中国半导体行业协会：今年全球封测市场规模将达899亿美元；（8）机构：2024年第三季度全球云计算支出达820亿美元，同比增长21%；（9）机构：2024年Q3全球云基础设施服务支出同比增长21%；（10）机构：Q3全球存储相关资本支出环比增长34%，同比增长67%；（11）英伟达：第三季度净利润193.1亿美元，同比增长109%；（12）鼎龙股份：临时键合胶首获数百万订单；（13）江波龙：首颗32Gbit 2D MLC NAND Flash已经完成流片验证；（14）佰维存储：公司在现有技术基础上进一步布局2.5D、3D先进封测能力。
- **周报观点：**近期海外扰动较多，如台积电11月11日宣布暂停向大陆客户提供7nm及以下工艺芯片，外媒报道出口限制措施将进一步收紧，如HBM禁令升级，芯片企业限制名单扩大等。目前部分传闻无法证实，但国产替代大势不可逆转，海外限制升级有望加速半导体设备、材料、算力芯片等环节的国产导入速度；AI终端方面，近期AI炒作从AI算力向下游AI终端、应用发散，主要催化为AI耳机、AI眼镜新品的密集落地，如字节、百度、Rokid等相继发布AI耳机或AI眼镜，政策方面，教育部办公厅日前发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，并提出加强顶层设计和部门协同，2030年前在中小学基本普及人工智能教育。耳机、AR/VR、智能手表等可穿戴设备作为重要的AI交互入口，有望受益这一进程。建议关注Nor Flash、Nand等硬件增量。
- **风险提示：**终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

目录

1. 半导体行业行情回顾	3
2. 半导体产业新闻	3
3. 公司公告与动态	5
4. 半导体产业数据更新	7
4.1 智能手机出货数据	7
4.2 新能源汽车销售数据	7
4.3 全球、国内半导体月度销售数据	7
4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据	8
5. 投资建议	8
6. 风险提示	11

插图目录

图 1: 半导体行业 2021 年初至今行情走势 (截至 2024 年 11 月 29 日)	3
图 2: 全球智能手机季度出货量	7
图 3: 国内智能手机月度出货情况	7
图 4: 新能源汽车销量及同比增长率	7
图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率	7
图 6: 全球半导体月度销售情况	8
图 7: 中国半导体月度销售情况	8
图 8: 全球半导体设备销售额 (季度)	8
图 9: 中国大陆半导体设备销售额 (季度)	8

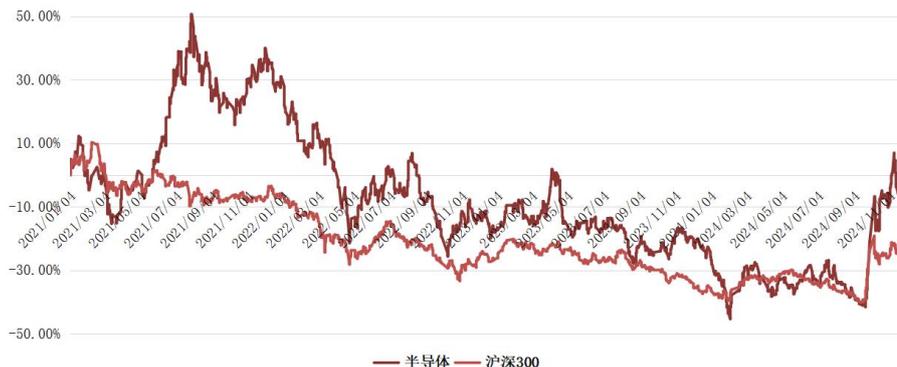
表格目录

表 1: 建议关注标的介绍 (2024/11/29)	9
----------------------------------	---

1. 半导体行业行情回顾

半导体行业指数近两周涨跌幅：截至 2024 年 11 月 29 日，半导体行业指数近两周（2024/11/18-2024/11/29）累计上涨 0.29%，跑赢沪深 300 指数 1.61 个百分点；11 月以来累计上涨 2.34%，跑赢沪深 300 指数 1.68 个百分点；2024 年以来累计上涨 24.79%，跑赢沪深 300 指数 10.64 个百分点。

图 1：半导体行业 2021 年初至今行情走势（截至 2024 年 11 月 29 日）



资料来源：iFind，东莞证券研究所

2. 半导体产业新闻

1. 【Canalys：2024 年 Q3 全球个人智能音频设备出货量同比增长 15%】

《科创板日报》18 日讯，2024 年第三季度，全球个人智能音频设备市场出现强势反弹，总出货量逼近 1.26 亿件，同比增长 15%。这标志着该市场连续第三个季度迎来上升态势，表明其已脱离 2023 年遭遇的困境，实现持续回升。

2. 【机构：需求展望疲弱 预计 2025 年 DRAM 价格将下跌】

《科创板日报》18 日讯，根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，2025 年 DRAM 价格将转为下跌。其中，制程较成熟的 DDR4 和 LPDDR4X 因供应充足、需求减弱，目前价格已呈现跌势。DDR5 与 LPDDR5X 等先进制程产品的需求展望尚不明确，加上部分买卖双方库存水位偏高，价格不排除于今年第四季度开始下跌。

3. 【机构：2024 年前三季度全球存储市场规模突破 1200 亿美元】

财联社 11 月 18 日电，服务器市场继续拉动对存储需求的增长，第三季度的全球存储市场规模延续二季度的增长趋势。据 CFM 闪存市场数据显示，2024 年三季度全球 NAND Flash 市场规模环比增长 5.7%至 190.21 亿美元，DRAM 市场规模环比增加 10.4%至 258.5 亿美元。全球存储市场规模三季度环比增长 8.3%至 448.71 亿美元。2024 年前三季度，全球存储市场规模累计达 1202.25 亿美元，同比增长 96.8%。

4. 【小米集团：第三季度营收 925.1 亿元 同比增长 30.5%】

财联社 11 月 18 日电，小米集团公告，第三季度营收 925.1 亿元，同比增长 30.5%，预估 902.8 亿元；集团经调整净利润为人民币 63 亿元，同比增长 4.4%，其中包括智能电动汽车等创新业务经调整净亏损人民币 15 亿元。

5. 【小米集团：第三季度智能手机收入同比增加 13.9%至 475 亿元】

财联社 11 月 18 日电，小米集团发布的第三季度财报显示，2024 年第三季度，全球智能手机出货量达到 4310 万台，同比增长 3.1%。智能手机收入由 2023 年第三季度的人民币 416 亿元增加 13.9%至 2024 年第三季度的人民币 475 亿元，主要是由于智能手机的平均售价（「ASP」）及出货量增加所致。

6. 【渠道存储市场氛围转淡 本周渠道 SSD 和内存条多数小跌】

《科创板日报》19 日讯，近期，随着双 11 收官渠道需求逐渐转淡，受低价资源短缺影响，渠道厂商竞价出货现象有所缓解，但客户价格接受度偏低，本周渠道 SSD/内存条价格小幅下跌；行业市场方面，近期部分 PC 客户追加订单，行业 SSD/内存条价格趋稳；继连跌近一个月之后，嵌入式产品报价也暂时维持不变。

7. 【中国半导体行业协会徐冬梅：今年全球封测市场规模将达 899 亿美元】

《科创板日报》19 日讯，在第二十一届中国国际半导体博览会上，中国半导体行业协会封装分会副秘书长徐冬梅引述 Yole 数据表示，预计 2024 年全球封测市场规模达到 899 亿美元，同比增长 5%；2026 年全球封测市场规模将有望达 961 亿美元，先进封装市场规模将达 522 亿美元，占比提高至 54%。

8. 【机构：2024 年 Q3 全球云基础设施服务支出同比增长 21%】

《科创板日报》19 日讯，Canalys 发布报告称，2024 年第三季度，全球云基础设施服务支出同比增长 21%，达到 820 亿美元。客户对超大规模企业 AI 产品的投资推动了增长，促使领先的云供应商加大对 AI 的投资。三大云供应商 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud 的排名与上一季度保持稳定，这三家供应商合计占总支出的 64%，这三家供应商的总支出同比增长 26%。

9. 【SK 海力士开始量产 321 层 NAND 闪存】

财联社 11 月 21 日电，SK 海力士宣布，开始量产全球最高的 321 层 1Tb（太比特，Terabit）TLC（Triple Level Cell）4D NAND 闪存。SK 海力士表示，计划从明年上半年起向客户提供 321 层产品。

10. 【英伟达：第三季度净利润 193.1 亿美元 同比增长 109%】

财联社 11 月 21 日电，英伟达第三季度营收 351 亿美元，同比增长 93.7%，市场预期 332.5 亿美元，第三季度数据中心收入 308 亿美元，市场预期 291.4 亿美元；第三季度净利润 193.1 亿美元，同比增长 109%，市场预期 169.3 亿美元；第三季度调整后每股收益 0.81 美元，市场预期 0.74 美元。英伟达预计第四财季营收为 375 亿

美元上下浮动 2%，分析师平均预期为 371 亿美元，低于最高预期的 410 亿美元。英伟达称 Blackwell 产品系列在未来几个季度将供不应求，未在财报中给出 Blackwell 的营收指引。

11. 【机构：2024 年第三季度全球云计算支出达 820 亿美元 同比增长 21%】

财联社 11 月 21 日电，Canalys 发布数据，2024 年第三季度，全球云基础设施服务支出同比增长 21%，达到 820 亿美元。客户对顶级云厂商 AI 产品的投资成为增长的主要推动力，这也促使主要云厂商加大了在 AI 领域的投入。前三大云厂商（AWS、微软 Azure 和谷歌云）的排名与上季度保持不变，三者合计占全球云支出的 64%。这三家厂商的总支出同比增长 26%，均实现了环比增长。市场领导者 AWS 的年增长率为 19%，与上季度持平，但增速低于微软（33%）和谷歌云（36%）。然而，从实际金额来看，AWS 的收入增长（同比增加约 44 亿美元）超过了微软和谷歌云。

12. 【机构：Q3 全球存储相关资本支出环比增长 34% 同比增长 67%】

《科创板日报》25 日讯，国际半导体产业协会（SEMI）最新数据显示，半导体资本支出方面，第三季度与存储相关的资本支出环比增长 34%，同比增长 67%，反映出存储 IC 市场与去年同期相比有所改善。预计第四季度总资本支出将较 2024 年第三季度水平增长 27%，同比增长 31%，其中与存储相关的资本支出同比增长 39%，领先于这一增长。

3. 公司公告与动态

1. 【鼎龙股份：临时键合胶首获数百万订单】

财联社 11 月 19 日电，鼎龙股份公告，公司先进封装材料-临时键合胶产品于近期首次收到国内某主流晶圆厂客户的采购订单。这是继今年 6 月公司半导体封装 PI 产品获得批量订单之后，第二款半导体先进封装材料在客户端实现销售。本次订单的签署，将持续巩固公司在半导体先进封装材料行业的产品优势，夯实公司在进口替代类新材料平台型企业的竞争优势。公司现拥有年产 110 吨的临时键合胶产能规模，具备量产供货能力。本次首获的临时键合胶订单涉及金额数百万元，暂未对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。

2. 【江波龙：首颗 32Gbit 2D MLC NAND Flash 已经完成流片验证】

财联社 11 月 25 日电，江波龙发布投资者关系活动记录表，在自研小容量存储芯片领域，公司拓展了 SLC NAND Flash 等小容量存储芯片设计能力，实质性构建了自研 SLC NAND Flash 存储芯片设计业务，产品获得客户高度认可，累计出货量已超 1 亿颗。同时，公司将以 SLC NAND Flash 作为起点，积累存储芯片设计能力与芯片工艺实现经验，渐进式地拓展 MLC NAND Flash 设计能力，首颗 32Gbit 2D MLC NAND Flash 已经完成流片验证，未来合适时间将发布样品。在主控芯片领域，公司已推出 eMMC 和 SD 卡主控芯片，并实现超千万颗的产品应用。公司自研主控芯片性能领

先，搭配自研固件算法，能够高效率满足客户产品需求，增加大客户黏性。

3. **【意法半导体让华虹代工 40nm MCU 华虹公司回应：属实】**

财联社 11 月 21 日电，有消息称意法半导体（ST）宣布与中国晶圆代工厂华虹半导体合作的新计划，将与华虹合作在中国生产 40nm 节点的微控制器单元（MCU）。记者向华虹公司求证上述合作信息的真实性，内部人士承认，有相关的合作，但是目前没有更多可以官方披露的信息。（21 财经）

4. **【佰维存储：公司在现有技术基础上进一步布局 2.5D、3D 先进封测能力】**

财联社 11 月 20 日电，佰维存储接受机构调研时表示，公司在品牌、技术、研发封测一体化构建和资本等方面均具备先发优势，是业内最早布局研发封测一体化的企业，从 2010 年开始就自建封测能力，有十几年的积累沉淀，存储封测的技术能力达到国内领先、国际一流的水平。同时，公司在现有技术基础上进一步布局 2.5D、3D 先进封测能力，不断提升技术壁垒；此外，公司也是业内率先进行主控自研存储解决方案的企业，在主控性能和国产化等方面具备竞争优势。在市场方面，公司在手机、PC、穿戴领域具有较好的客户基础。

5. **【北京君正：推出异构多核处理器 X2600 等 应用于扫地机器人等领域】**

财联社 11 月 21 日电，有投资者问北京君正，公司有没有机器人方面适用芯片？北京君正在互动平台表示，公司推出的异构多核处理器 X2600，T41 等，应用在扫地机器人、斗宠机器人等领域。

6. **【江化微：拟 3.38 亿元收购控股子公司镇江江化微少数股东股权】**

财联社 11 月 22 日电，江化微公告，公司拟以并购贷款 2.03 亿元及自有资金 1.35 亿元合计 3.38 亿元收购控股子公司镇江江化微的少数股东权益。收购完成后，公司将持有镇江江化微 100% 的股权。本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

7. **【芯海科技：公司多款车规级 MCU 芯片已导入多家汽车客户并开始量产】**

财联社 11 月 28 日电，芯海科技发布投资者关系活动记录表公告，公司多款车规级 MCU 芯片取得阶段性成果，已导入多家汽车客户并开始量产。车规级的高精度 Sigma-Delta ADC 和高速高精度 SAR ADC 已经在头部客户端实现量产。此外，公司 EC 芯片在计算机头部客户端实现大规模量产，第二代 EC 芯片通过英特尔 PCL 认证。公司传感器调理芯片已实现批量出货。在鸿蒙系统开发与应用方面，芯海是鸿蒙的生态合作伙伴，已成功导入 245 个鸿蒙智联项目商机，完成 97 个 SKU 的产品接入。

4. 半导体产业数据更新

4.1 智能手机出货数据

全球智能手机出货数据: 根据 IDC 数据, 2024 年第三季度全球智能手机出货量为 3.16 亿台, 同比增长 4.01%, 环比增长 10.76%; 2024 年 1-9 月全球智能手机出货量为 8.91 亿台, 同比增长 6.34%。

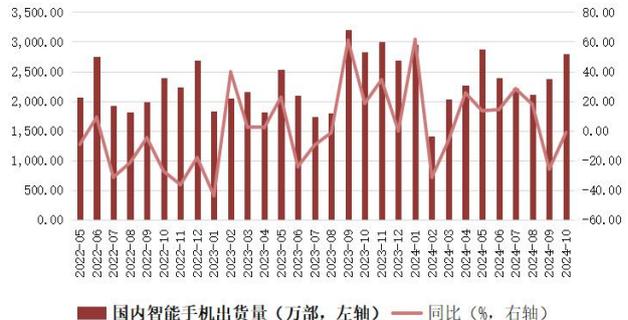
国内智能手机出货数据: 根据工信部数据, 2024 年 10 月国内智能手机出货量为 2,788.40 万台, 同比下降 1.10%, 环比增长 17.57%。2024 年 1-10 月国内智能手机累计出货量为 2.34 亿台, 同比增长 6.38%。

图 2: 全球智能手机季度出货量



资料来源: IDC, 东莞证券研究所

图 3: 国内智能手机月度出货情况



资料来源: 工信部, 东莞证券研究所

4.2 新能源汽车销售数据

新能源汽车销售数据: 据工信部, 2024 年 10 月, 国内新能源汽车总销量为 143.0 万辆, 同比增长 49.6%, 环比增长 11.11%, 2024 年 10 月国内汽车总销量为 305.3 万台, 其中新能源汽车销量占比为 46.84%。

图 4: 新能源汽车销量及同比增长率



资料来源: 中汽协, 东莞证券研究所

图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率



资料来源: 中汽协, 东莞证券研究所

4.3 全球、国内半导体月度销售数据

全球、中国半导体销售数据: 根据美国半导体行业协会数据, 2024 年 9 月全球半导体销售额达到了 553.2 亿美元, 同比增长 23.2%, 环比增长 4.1%, 单月销售额再创历史新高,

同比增幅为自 2022 年 2 月以来的最大值。国内方面，国内半导体 2024 年 9 月销售额为 160.4 亿美元，同比增长 22.9%，环比增长 3.6%，全球和中国半导体销售额均连续 11 个月实现同比正增长。

图 6：全球半导体月度销售情况

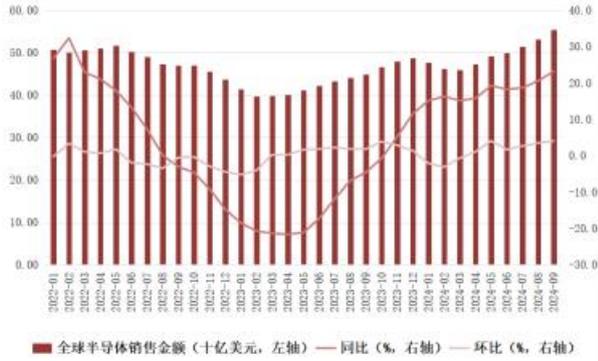


图 7：中国半导体月度销售情况



资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

资料来源：美国半导体产业协会，东莞证券研究所

4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据

全国、中国大陆半导体设备销售额：根据 SEAJ 数据，2024 年第二季度全球半导体设备销售额为 267.8 亿美元，同比增长 4.00%，其中中国大陆半导体设备销售额为 122.1 亿美元，同比增长 62.00%。

图 8：全球半导体设备销售额（季度）



图 9：中国大陆半导体设备销售额（季度）



资料来源：SEAJ，东莞证券研究所

资料来源：SEAJ，东莞证券研究所

5. 投资建议

近期海外扰动较多，如台积电 11 月 11 日宣布暂停向大陆客户提供 7nm 及以下工艺芯片，外媒报道出口限制措施将进一步收紧，如 HBM 禁令升级，芯片企业限制名单扩大等。目前部分传闻无法证实，但国产替代大势不可逆转，海外限制升级有望加速半导体设备、材料、算力芯片等环节的国产导入速度；AI 终端方面，近期 AI 炒作从 AI 算力向下游 AI 终端、应用发散，主要催化为 AI 耳机、AI 眼镜新品的密集落地，如字节、百度、Rokid 等相继发布 AI 耳机或 AI 眼镜，政策方面，教育部办公厅日前发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，并提出加强顶层设计和

部门协同, 2030年前在中小学基本普及人工智能教育。耳机、AR/VR、智能手表等可穿戴设备作为重要的AI交互入口, 有望受益这一进程。建议关注Nor Flash、Nand等硬件增量。

建议关注标的:

北方华创(002371)、中微公司(688012)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、鼎龙股份(300054)、江丰电子(300666)、海光信息(688041)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)、通富微电(002156)、韦尔股份(603501)、思特威(688213)、卓胜微(300782)。

表 1: 建议关注标的介绍 (2024/11/29)

股票代码	股票名称	最新业绩情况
002371	北方华创	公司 2024 年前三季度实现营收 203.53 亿元, 同比增长 39.51%, 实现归母净利润 44.63 亿元, 同比增长 54.62%, 对应 24Q3 营收为 80.18 亿元, 同比+30.12%, 环比+23.81%, 对应 24Q3 归母净利润为 16.82 亿元, 同比+55.02%, 环比+1.68%。报告期内, 受益半导体设备国产替代趋势, 公司经营业绩实现同比增长, 其中电子工艺装备收入同比增长 46.96%, 使得整体营业收入增加。
688012	中微公司	公司 2024 年第三季度实现营业收入 20.59 亿元, 同比增长 35.96%, 环比增长 11.77%, 实现归母净利润 3.96 亿元, 同比增长 152.63%, 环比增长 48.11%。报告期内, 公司刻蚀设备实现高速增长, 前三季度刻蚀设备收入为 44.13 亿元, 同比增长 53.77%, 且报告期内 LPPVD 设备新品实现首台销售, EPI 设备顺利进入客户量产验证阶段, 结果获得客户认可。
688120	华海清科	公司 2024 年前三季度实现营收 24.52 亿元, 同比增长 33.22%, 实现归母净利润 7.21 亿元, 同比增长 27.80%, 对应 24Q3 营收为 9.55 亿元, 同比+57.63%, 环比+17.00%, 对应 24Q3 归母净利润为 2.88 亿元, 同比+51.74%, 环比+24.97%。报告期内, 公司积极把握集成电路产业需求拉动所带来的市场机遇, 持续加大研发投入和生产能力建设, 增强了企业核心竞争力, 公司 CMP 产品作为集成电路前道制造的关键工艺装备之一, 获得了更多客户, 市场占有率不断提高。随着公司 CMP 产品的市场保有量不断扩大, 关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量, 同时晶圆再生及湿法装备收入逐步增加, 公司营业收入较同期增长。
688072	拓荆科技	公司 2024 年前三季度实现营收 22.78 亿元, 同比增长 33.79%, 实现归母净利润 2.71 亿元, 同比增长 0.10%, 对应 24Q3 营收为 10.11 亿元, 同比+44.67%, 环比+27.14%, 对应 24Q3 归母净利润为 1.42 亿元, 同比-2.91%, 环比+19.87%。公司 2024 年三季度营收实现同比高速增长, 目前已经实现全系列 PECVD 介质薄膜材料的覆盖, 广泛应用于国内集成电路客户的制造产线, 量产规模和产品品类持续扩大。
300604	长川科技	公司 2024 年前三季度实现营收 25.35 亿元, 同比增长 109.72%, 实现归母净利润 3.57 亿元, 同比增长 26,858.78%, 对应 24Q3 营收为 10.07 亿元, 同比+125.51%, 环比+3.98%, 对应 24Q3 归母净利润为 1.43 亿元, 同比+844.11%, 环比-32.39%。作为国内半导体测试设备平台型企业, 公司产品涵盖测试机、分选机、探针台、AOI 等多个品类, 下游客户涵盖长电、华天、通富、日月光等封装龙头企业, 且在国内客户的导入进度加速, 通过内生外延持续打开成长空间。
300054	鼎龙股份	公司 2024 年前三季度实现营收 24.26 亿元, 同比增长 29.54%, 实现归母净利润 3.76 亿元, 同比增长 113.51%, 对应 24Q3 营收为 9.07 亿元, 同比+27.17%, 环比+11.85%, 对应 24Q3 归母净利润为 9.07 亿元, 同比+27.17%, 环比+11.85%。公司目前重点聚焦半导体创新材料领域中: 半导体制造用 CMP 工

表 1: 建议关注标的介绍 (2024/11/29)

股票代码	股票名称	最新业绩情况
		艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。报告期内，受益半导体行业复苏及下游客户国产替代导入加速，公司各项业务进展顺利，带动经营业绩实现同比增长。
300666	江丰电子	公司 2024 年前三季度实现营收 26.25 亿元，同比增长 41.77%，实现归母净利润 2.87 亿元，同比增长 48.51%，对应 24Q3 营收为 9.98 亿元，同比+52.48%，环比+16.69%，对应 24Q3 归母净利润为 1.26 亿元，同比+213.13%，环比+23.85%。报告期内，公司超高纯靶材销售持续增长，且精密零部件产品加速放量，带动经营业绩实现同比增长。
688041	海光信息	公司 2024 年前三季度实现营收 61.37 亿元，同比增长 55.64%，实现归母净利润 15.26 亿元，同比增长 69.22%，对应 24Q3 营收为 23.74 亿元，同比+78.33%，环比 9.34%，对应 24Q3 归母净利润为 6.72 亿元，同比+199.90%，环比+19.02%。公司三季度业绩表现亮眼，Q3 单季度毛利率创历史新高，主要原因为贸易摩擦背景下国产算力需求维持较高景气，以及信创业务边际回暖。
603986	兆易创新	公司 2024 年前三季度实现营收 56.50 亿元，同比增长 28.56%，实现归母净利润 8.32 亿元，同比增长 91.87%，对应 24Q3 营收为 20.41 亿元，同比+542.83%，环比+2.97%，对应 24Q3 归母净利润为 3.15 亿元，同比+222.55%，环比+0.93%。经历 2023 年市场需求低迷和库存逐步去化后，2024 年上半年消费、网通市场出现需求回暖，第三季度工业、存储与计算市场库存有效去化，公司积极跟进市场需求变化，营业收入同比实现显著增长。
688008	澜起科技	公司 2024 年前三季度实现营收 25.71 亿元，同比增长 68.56%，实现归母净利润 9.78 亿元，同比增长 318.42%，对应 24Q3 营收为 9.06 亿元，同比+51.60%，环比-2.35%，对应 24Q3 归母净利润为 3.85 亿元，同比+153.40%，环比+4.10%。分业务来看，2024 年前三季度互联类产品线销售收入约为 23.77 亿元，较上年同期增长 59.37%，津逮®服务器平台产品线销售收入约为 1.85 亿元，较上年同期增长 565.34%
600584	长电科技	公司 2024 年前三季度实现营收 249.78 亿元，同比增长 22.26%，实现归母净利润 10.76 亿元，同比增长 10.55%，对应 24Q3 营收为 94.91 亿元，同比+14.95%，环比+9.80%，对应 24Q3 归母净利润为 4.57 亿元，同比-4.39%，环比-5.57%。三季度为消费电子传统旺季，公司大客户业务上升，单季度营收创历史新高，公司 Q3 净利润同比下滑，主要系汇兑损失影响所致。
002156	通富微电	公司 2024 年前三季度实现营收 170.81 亿元，同比增长 7.38%，实现归母净利润 5.53 亿元，同比增长 967.83%，对应 24Q3 营收为 60.01 亿元，同比+0.04%，环比+3.50%，对应 24Q3 归母净利润为 2.30 亿元，同比+85.32%，环比+2.53%。报告期内受益下游人工智能快速发展，公司 Q3 经营业绩实现同比、环比提升，9 月 20 日，公司子公司通富通科举行 Memory 二期项目首台设备入驻仪式，表明公司二期项目扩产顺利，后续有望带来新的业绩增长点。
603501	韦尔股份	公司 2024 年前三季度实现营收 189.08 亿元，同比增长 25.38%，实现归母净利润 23.75 亿元，同比增长 544.74%，对应 24Q3 营收为 68.17 亿元，同比+9.55%，环比+5.73%，对应 24Q3 归母净利润为 10.08 亿元，同比+368.33%，环比+24.60%。随着消费市场进一步回暖，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入实现了明显增长；同时，受到产品结构优化以及成本控制等因素影响，公司产品毛利率逐步恢复。
688213	思特威	公司 2024 年前三季度实现营收 42.08 亿元，同比增长 137.33%，实现归母净利润 2.73 亿元，同比增长 517.32%，对应 24Q3 营收为 17.51 亿元，同比+150.04%，环比+8.10%，对应 24Q3 归母净利润为 1.23 亿元，同比+14,181.63%，环比-9.09%。2024 年年初至报告期末，公司在智能手机、汽车电子和智慧安防三大应用领域的出货均取得较高的增速，带动收入规模大幅增长。在智慧安防领域，公司新推出的迭代产品具备更优异的性能和竞争力，产品销量有较大的上升，销售收入增加较为显著；在智能手机领域，公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶 5000 万像素产品出货量大幅上升；同时公司与客户的合作全面加深、产品满足更多的应用需求，市场占有率持续提升，带动公司

表 1: 建议关注标的介绍 (2024/11/29)

股票代码	股票名称	最新业绩情况
		在智能手机领域的营收显著增长，成功开辟出第二条增长曲线。
300782	卓胜微	公司 2024 年第三季度实现营收 10.83 亿元，同比下降 23.13%，环比下降 1.13%，实现归母净利润 0.71 亿元，同比下降 84.29%，环比下降 54.63%。报告期内公司经营业绩承压，主要系自建芯卓产线前期大幅折旧，2024 年前三季度公司固定资产折旧变动金额约为 4.13 亿元，且研发投入大幅增加，拖累整体盈利表现。报告期内，公司 6 英寸 SAW 滤波器、12 英寸 IPD 滤波器业务进展顺利，已达到较高自产比例，且射频开关产品在三季度已集成至模组开始量产出货。2024 年三季度，公司已完成 L-PAMiD 的新一轮产品迭代，后续有望贡献业绩。

资料来源：iFind，东莞证券研究所

6. 风险提示

- (1) **终端需求不及预期：** 智能手机、PC 构成半导体的主要下游应用领域之一，若后续下游需求不及预期，则可能对相关上市公司业绩造成不利影响；
- (2) **国产替代不及预期：** 若半导体设备、材料等企业技术突破不如预期导致国产替代进程受阻，则可能面临业绩增速放缓的风险；
- (3) **价格竞争加剧：** 若业内上市企业进行大量产能扩张，则行业未来可能面临产能过剩的局面，带来价格竞争导致盈利能力下滑的风险。

东莞证券研究报告评级体系:

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内, 股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内, 股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内, 股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内, 股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 导致无法给出明确的投资评级; 股票不在常规研究覆盖范围之内

行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明: 本评级体系的“市场指数”, A股参照标的为沪深 300 指数; 新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告, 市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板(含退市整理期)等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告, 港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系: “保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报, “谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报, “稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报, “积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报, “激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺:

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点, 不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系, 没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益, 或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明:

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司, 具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠, 但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告, 亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下, 本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用, 并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险, 据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有, 未经本公司事先书面许可, 任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发, 需注明本报告的机构来源、作者和发布日期, 并提示使用本报告的风险, 不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的, 应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码: 523000

电话: (0769) 22115843

网址: www.dgzq.com.cn